

概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於此乃概要，故並無載列所有可能對閣下屬重要的資料。閣下於決定[編纂][編纂]前，務請仔細閱讀整份文件。

任何[編纂]均涉及風險。[編纂][編纂]的若干特定風險載於本文件「風險因素」一節。閣下於決定[編纂][編纂]前，務請仔細閱讀該節。

概覽

我們是全球領先的高性能非易失性存儲芯片設計公司，我們以無晶圓廠模式營運，專注於設計流程及外包晶圓製造、封裝及測試，致力於滿足人工智能時代高速迭代與擴容的存儲需求，為客戶研發及供應(i)關鍵非易失性存儲芯片，如串行檢測集線器(SPD)芯片(該品類下的主要產品)、電可擦除可編程只讀存儲器(EEPROM)芯片及或非易失性閃存(NOR Flash)芯片；(ii)攝像頭馬達驅動芯片；及(iii)近場通信(NFC)芯片及配套解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年、2024年及2025年，按收入計，我們是全球排名第三的EEPROM供應商以及排名第二的DDR5 SPD芯片供應商。憑藉強大的技術研發專長與全球市場積累，我們的產品組合現已覆蓋AI基礎設施、汽車電子、工業控制、消費電子等廣泛的存儲應用場景。

存儲芯片已滲透至人類社會運轉的方方面面。AI基礎設施(如數據中心和服務器集群)正隨著人工智能的發展而迅速擴張。智能駕駛、視覺感知等隨著汽車智能化發展不斷革新的車規級應用，乃至智能手機、家電等日常隨處可見的消費電子領域，均依賴於高性能且高可靠的存儲芯片產品。存儲芯片不僅承擔著系統啟動、參數存儲、程序加載等基礎功能，更在實時數據處理、邊緣計算、多任務併發等複雜場景中發揮著關鍵作用，其應用範圍延伸至幾乎所有電子場景，成為支撐數字化社會運轉不可或缺的核心元件。

AI時代，算力承擔模型訓練與推理的核心運算任務，而存力在數據的採集、傳輸、緩存與持久化方面發揮關鍵基石性的作用。在人工智能的驅動下，大模型訓練規模持續擴大，推理應用向各類終端行業加速滲透，全球數據的快速增長正在加速存儲技術的升級，並重塑存儲類芯片產業的角色與價值。

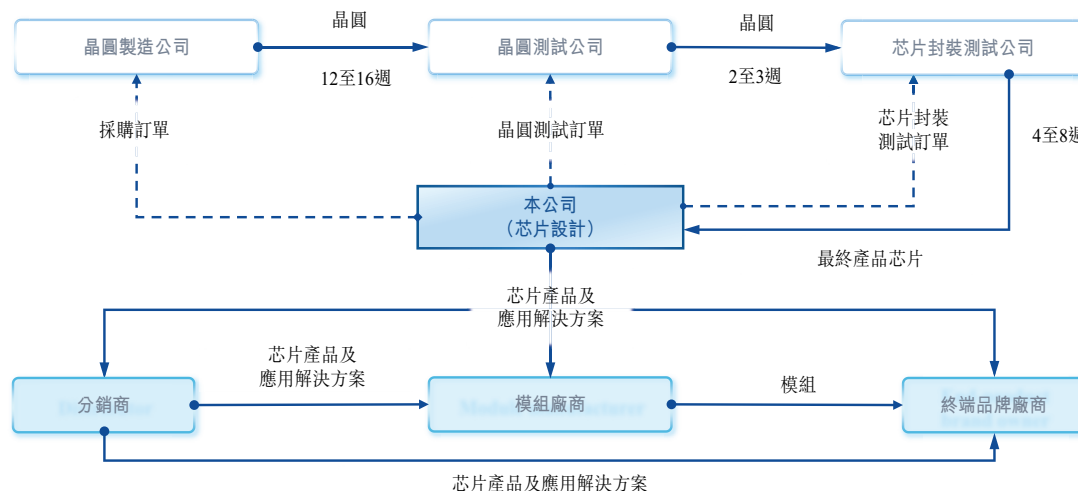
在這一趨勢下，當前存儲芯片的裝載密度和性能要求正在被提升至前所未有的高度。隨著人工智能、物聯網、5G通信等新一代信息技術的深度融合與快速滲透，各類電子設備對數據存儲的容量、速度、功耗及可靠性提出了更為嚴苛的要求。

基於逾16年的行業深耕與對市場需求的深刻理解，我們已開發出以非易失性存儲芯片、攝像頭馬達驅動芯片以及NFC芯片為核心的產品線，我們追求項目定點以展示我們的技術能力並建立客戶信任、推動產品從試產邁向量產，並利用這些已建立的關係把握交叉銷售機會。因此，我們的產品已得到全球內存模組巨頭、中國及境外知名汽車企業、主流智能手機廠商等下游終端客戶的廣泛應用。根據弗若斯特沙利文的資料，2025年，我們按收入計擁有全球DDR5 SPD芯片市場超過40%的份額，且按收入計擁有全球EEPROM市場14.8%的份額，並在多個細分產品領域擁有全球領先的研發能力與市場地位。

概 要

我們的業務模式

我們採取無晶圓廠業務模式，專注於芯片產品的研發、設計與銷售。



我們的產品亮點

我們的產品組合包括(1)涵蓋若干核心存儲應用場景的非易失性存儲芯片，包括以支持DDR2至DDR5（第二代至第五代雙倍數據速率）內存模組的全系列SPD芯片為亮點的存儲模組配套芯片、面向汽車電子、工業控制的高可靠性存儲芯片以及面向消費電子領域的存儲芯片；(2)攝像頭馬達驅動芯片；及(3)其他產品，主要包括NFC芯片。

存儲模組配套芯片。我們自DDR2世代即已研發內存模組配套SPD芯片，針對最新的DDR5內存技術，憑藉多年的量產經驗與核心技術積累，我們與一家全球領先的內存互聯芯片供應商建立深度合作。我們的共同開發模式使我們能夠作為戰略合作夥伴的DDR5內存接口解決方案所需SPD芯片的核心供應商，該解決方案被全球主要內存公司（尤其是全球一流的動態隨機存取存儲器(DRAM)模組公司）廣泛採用。我們正積極拓展新產品線，並已推出配套下一代高性能存儲設備的關鍵產品數據(VPD)芯片。

用於汽車電子的高可靠性存儲芯片。汽車電子是當前存儲芯片領域最具確定性和增長潛力的核心市場之一。其對於存儲芯片的可靠性、溫度適應能力與抗干擾能力所提出的嚴苛要求，正在業界建立競爭壁壘，使我們這樣的領先企業受益。我們用於汽車電子的高可靠性存儲芯片符合AEC-Q100 A1-A2標準，EEPROM容量覆蓋1Kb-4Mb、NOR Flash容量覆蓋512Kb-16Mb。憑藉我們的先發優勢並順應國內車企國產化趨勢，我們的產品已廣泛應用於全球前20大中的16大、中國前20大的所有汽車品牌以及中國逾85%的自主乘用車品牌的多個核心車載模塊。

應用於消費電子領域的存儲芯片。我們應用於消費電子領域的存儲類芯片包含高性能EEPROM以及先進的NOR Flash產品。我們提供覆蓋1Kb-4Mb容量區間的全系列EEPROM芯片。我們的NOR Flash產品聚焦低功耗SPI NOR Flash芯片系列，包括基於我們NORD工藝平台的覆蓋512Kb-64Mb容量區間的NOR Flash芯片，以及基於ETOX工藝平台的覆蓋32Mb-512Mb容量範圍的NOR Flash產品儲備，以滿足若干消費電子終端產品的更大固件需求，為客戶提供多層次選擇。我們長期深耕智能手機這一消費電子領域內市場規模最大的細分市場，我們的EEPROM芯片自2011年起即已應用於全球領先智能手機品牌之一的攝像頭模組中。憑藉逾16年的行業經驗，我們持續推動產品升級，以滿足人工智能時代尚未被滿足的需求。

下圖載列我們的主要產品、其功能、核心技術及應用。

概 要				
核心產品線	主要產品	主要功能	核心技術領域	關鍵應用
非易失性存儲芯片	存儲模組配套芯片	身份識別、配置存儲、管理通道和熱遙測 (DDR2-DDR5)	SPD芯片技術 (關鍵技術功能模塊包括EEPROM、I²C/I³C集線器和溫度傳感器)	- AI服務器及AI PC - DDR5內存接口解決方案，其在動態隨機存取存儲器 (「DRAM」) 中獲廣泛採用 - DDR2-DDR4內存模組
	用於汽車電子的高可靠性存儲芯片	高可靠性可重新編程的數據保存	- EEPROM (容量區間介乎1 Kb至4 Mb) - NOR Flash (容量區間介乎512 Kb至16 Mb)	- 汽車車載模組，包括視覺感知、智能座艙、電動化動力總成及車身／底盤 - 工業控制應用，包括工業自動化、數字能源與電力電子、通信基礎設施與光模組。
	消費電子存儲類芯片	用於消費電子場景的可重新編程的數據保存	- EEPROM (容量區間介乎1 Kb至4 Mb) - NOR Flash (NORD覆蓋512 Kb至64 Mb容量區間及基於ETOX的覆蓋32 Mb至512 Mb容量區間的產品儲備)	- 智能手機與移動成像 - 顯示系統 - 連接與音頻配件 - 可穿戴設備與AI眼鏡
攝像頭馬達驅動芯片	攝像頭馬達驅動芯片	攝像頭模組的精確運動控制	- 電流驅動及建立 - 校準及公差處理 - 精密傳感及控制 - OIS控制	- 智能手機 - 手持雲台 - 其他緊湊型成像裝置
NFC芯片及其他	NFC芯片	近場數據識別	具有內嵌非易失性存儲模組的近場通信技術	- 電子價簽 - 消費電子產品與智能家居裝置 - 大型家電與小型家用設備 - 包裝、配件與品牌互動 - 輕工業與設施應用

雖然每項產品在其各自的模組內獨立運行，但其可共同滿足同一終端系統的不同功能需求。請參閱「業務 — 概覽 — 我們的產品亮點 — 單一場景中的多元化應用」。

我們的市場機會

AI服務器及AI PC。隨著大模型訓練與推理加快落地，全球AI基礎設施進入新一輪投資週期，用於承載雲端算力的AI服務器市場以及具備本地推理能力的AI PC市場正迎來爆發式增長。AI基礎設施的加速放量帶來整機存儲配置數量的系統性提升。數據中心側，主流AI服務器通常部署超過20根DDR5內存模組，是傳統服務器的兩倍，服務器逐步配置更多DRAM及SSD (固態硬盤，一種使用閃存的快速耐用的存儲設備) 模組。終端側，AI PC在PC端加快滲透，較之傳統產品，其配置更大容量的DRAM及SSD。在此背景下，我們已投入商業應用並支持DDR5的SPD芯片，以及目前正處於認證階段、用於eSSD和CXL模組的VPD芯片，有望獲得全球主要雲服務商、服務器廠商及AI PC品牌的採用及／或更廣泛部署，從而擴大我們的核心客戶覆蓋範圍，並深入滲透至AI基礎設施領域。

汽車電子。汽車智能化、電動化、網聯化轉型持續推進，整車電子電氣架構加速向域控制、區域控制演進。智能駕駛域控制器、智能座艙域控制器以及車身、底盤、電池管理等控制單元數量明顯增加，且在感知、控制、顯示、動力等多個模塊中配置

概 要

獨立的存儲芯片，用於支撐軟件運行和功能管理。單車配備的存儲芯片在種類和數量上均明顯高於傳統燃油車，呈現由「少量關鍵節點」向「多域多節點」擴展的升級趨勢。我們擁有應用於汽車電子領域的EEPROM、NOR Flash等高性能存儲類芯片產品，憑藉產品的高可靠性和穩定性，有望隨著市場擴容趨勢加速滲透全球汽車品牌的各類車型及功能模塊。

消費電子。消費電子終端出貨規模大、下游覆蓋人群廣，產品保有量和更新需求均處於較高水平，且邊緣AI功能在不同價位、不同形態產品中正在持續滲透，單機存儲芯片用量整體呈上升趨勢，為存儲芯片提供了體量可觀且持續擴大的應用空間。據弗若斯特沙利文統計，2025年全球支持邊緣AI的消費電子設備出貨量將突破8.5億台，滲透率超40.0%。我們的存儲類芯片產品已應用於智能手機及邊緣AI應用等端側AI終端，在多家品牌客戶中實現批量出貨，邊緣AI的快速發展也將持續擴大市場對我們產品的需求規模。

我們的優勢

我們相信，以下優勢將使我們更能掌握未來的產業機遇，實現持續成長：(i)在多個內存細分市場保持差異化能力，有效抓住結構性增長機會；(ii)在連續幾代產品中以客戶為導向的創新；(iii)高黏性優質客戶群，並可實現高效協同銷售；(iv)高速響應、高效協同的供應鏈網絡；及(v)富有經驗的管理與研發團隊。

我們的戰略

我們將實施以下戰略：(i)深化我們在成熟細分市場的優勢；(ii)繼續深化與各領域頭部客戶的合作，堅持長期發展策略，專注於技術創新，為客戶持續創造價值；(iii)依托平等、開放、高效、務實的企業文化，以多種方式持續拓展我們的產品線；及(iv)深化海外佈局，強化供應鏈與團隊建設。

我們的客戶及供應商

於往績記錄期間各年度／期間，我們的前五大客戶分別佔我們2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月總收入的57.7%、57.5%、55.5%及43.6%。於往績記錄期間各年度／期間內來自單一最大客戶的收入於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月分別為人民幣161.4百萬元、人民幣353.7百萬元、人民幣453.9百萬元及人民幣74.8百萬元，分別佔相應年／期內我們收入的22.9%、34.4%、37.2%及26.7%。於往績記錄期間，我們為廣泛的客戶群提供服務，其中許多是內存模組、汽車電子、工業控制及消費電子領域的全球領先企業。同時，我們也通過分銷商銷售我們的產品。於往績記錄期間，我們與主要客戶保持穩定的業務關係。

我們的供應商主要包括第三方晶圓代工廠及半導體封裝測試外包(OSAT)公司。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們委聘4家晶圓代工廠及33家OSAT公司。於往績記錄期間各年度／期間，我們向前五大供應商的採購額分別佔我們於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月總採購額的90.1%、91.3%、85.0%及81.9%。我們的原材料主要為晶圓和封裝及測試材料。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無遇到任何導致生產中斷的原材料供應短缺或延誤。我們相信，我們與供應商的穩定關係將繼續確保原材料的充足穩定供應，並有助於控制未來的價格波動。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的原材料並無出現對我們的營運產生重大影響的質量問題。

我們產品的銷售網絡

根據市場慣例，我們借助分銷商支持我們的產品銷售。我們的分銷商承擔客戶支持的責任。向分銷商銷售產品及解決方案的收入分別佔我們2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月收入的約68.7%、54.0%、51.4%及60.2%。

我們的直銷模式是主要服務於AI服務器、汽車電子、工業控制和消費電子行業的頭部戰略客戶。我們相信，我們的直銷有助於我們鞏固及提高市場份額，並有效滲透不同的垂直行業。

概 要

品牌推廣及營銷

我們致力於通過提供卓越的產品質量、可靠的性能、專業的技術支持服務以及協同的研發能力，並輔以精準的營銷舉措，來提升品牌知名度。具體而言，我們的銷售及營銷策略旨在建立品牌認知度、增加客戶對我們產品與解決方案的需求、培養與客戶的長期戰略合作夥伴關係、推動交叉銷售機會，並挖掘潛在的增量業務。

我們的銷售及營銷策略亦側重於與行業頭部的模組廠商和終端品牌廠商建立業務及技術關係，以便就符合其產品路線圖的未來半導體解決方案與彼等緊密合作。我們與客戶緊密合作，設計出綜合解決方案，以提升彼等產品的性能及效率。我們亦直接向服務器、汽車、PC及智能手機製造商營銷我們的產品，以便我們的產品能夠獲得其規格認證並設計納入其產品中。尤其在汽車領域，我們的車規級芯片已獲得多家全球一級供應商的認證，可部署於領先的汽車製造商平台及其他終端系統。

我們的市場機會與競爭

非易失性存儲芯片作為在斷電環境下仍可永久保存數據的核心硬件，已成為AI服務器、汽車電子、消費電子等關鍵產業發展的戰略性基礎元件與數據存儲基石。根據弗若斯特沙利文的資料，未來隨著AI服務器、AI PC、汽車電子及消費電子等下游市場的爆發式增長，預計全球非易失性存儲芯片市場規模將於2030年達到1,359億美元。

根據弗若斯特沙利文的資料，2025年，我們按收入計持有全球DDR5 SPD芯片市場超過40%的份額，且按收入計持有全球EEPROM市場14.8%的份額。然而，我們產品及解決方案的市場總體上競爭激烈，其特點是技術持續變革、行業標準不斷演變以及平均售價波動。我們的競爭對手包括國內外大型半導體公司，彼等可能在關鍵市場擁有更大的影響力、更穩固及龐大的客戶群，且總體上比我們更容易獲得其他資源。有關半導體行業市場環境的描述，請參閱「行業概覽」一節。

主要財務資料概要

以下載列的主要財務資料概要摘自本文件附錄一會計師報告所載我們的歷史財務資料（包括隨附附註），以及「財務資料」一節所載資料，應與該等資料一併閱讀。我們的歷史財務資料乃根據國際財務報告會計準則編製。

綜合損益表概要

下表載列所示年度／期間的綜合損益表：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(以千元計，百分比除外)						(未經審核)			
收入	703,477	100.0	1,028,277	100.0	1,221,284	100.0	261,066	100.0	279,994	100.0
銷售成本	(375,738)	(53.4)	(464,688)	(45.2)	(521,612)	(42.7)	(103,665)	(39.7)	(142,980)	(51.1)
毛利	327,739	46.6	563,589	54.8	699,672	57.3	157,401	60.3	137,014	48.9
除稅前溢利	84,664	12.0	298,571	29.0	379,779	31.1	103,932	39.8	32,247	11.5
所得稅（開支）／抵免	(1,969)	(0.3)	(22,531)	(2.2)	(23,941)	(2.0)	(6,493)	(2.5)	283	0.1
年／期內溢利	82,695	11.8	276,040	26.8	355,838	29.1	97,439	37.3	32,530	11.6
歸屬於：										
母公司擁有人	100,358	14.3	290,270	28.2	363,576	29.8	99,481	38.1	30,844	11.0

概 要

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(以千元計，百分比除外)						(未經審核)			
非控股權益.....	(17,663)	(2.5)	(14,230)	(1.4)	(7,738)	(0.6)	(2,042)	(0.8)	1,686	0.6

非國際財務報告準則指標

為補充我們根據國際財務報告會計準則呈列的綜合損益表，我們採用經調整淨利潤（非國際財務報告準則指標）及經調整淨利潤率（非國際財務報告準則指標），該等指標並非國際財務報告會計準則所要求或根據其呈列。我們將經調整淨利潤（非國際財務報告準則指標）定義為經加回以權益結算的股份支付開支調整後的年／期內利潤。股份支付開支以權益結算，並與我們的受限制A股激勵計劃有關，該計劃旨在向對本集團業務的成功作出貢獻的合資格參與者提供激勵及回報。以權益結算的股份支付開支屬非現金性質。因此，我們剔除該等股份支付開支的影響。我們將經調整淨利潤率（非國際財務報告準則指標）定義為經調整淨利潤（非國際財務報告準則指標）除以年／期內相應收入。我們認為，非國際財務報告準則指標有助於比較運營表現，並為投資者及其他人士提供有用的信息，使其能以與管理層相同的方式理解及評估我們的運營表現。然而，我們列示的各年／期內非國際財務報告準則指標未必可與其他公司所列示的類似名稱的指標相比。使用非國際財務報告準則指標作為分析工具有其局限性，投資者不應將其獨立於根據國際財務報告會計準則呈報的經營業績或財務狀況作考慮，或以其代替根據國際財務報告會計準則呈報的經營業績或財務狀況的分析。

下表將所呈列期間的非國際財務報告準則指標，與根據國際財務報告會計準則編製之最接近指標進行對賬。

	截至12月31日止年度			截至3月31日止三個月	
	2023年	2024年	2025年	2025年	2026年
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
	(以千元計，百分比除外)			(未經審核)	
年／期內利潤	82,695	276,040	355,838	97,439	32,530
已就下列各項作出調整：					
以權益結算的股份支付安排	44,643	29,292	32,329	3,637	23,852
經調整淨利潤（非國際財務報告準則指標）	<u>127,338</u>	<u>305,332</u>	<u>388,167</u>	<u>101,076</u>	<u>56,382</u>
經調整淨利潤率（非國際財務報告準則指標）	18.1%	29.7%	31.8%	38.72%	20.14%

由2023年至2025年，我們的收入及利潤持續增長主要歸因於以下產品貢獻的收入增加：(i) SPD芯片，主要得益於AI應用的普及加速；(ii)車規級芯片，主要得益於智能交通趨勢的興起以及整車廠國產化採購的增加；及(iii)工業級存儲芯片，主要得益於工業控制應用需求增長。伴隨著AI服務器及AI PC需求增加、我們在汽車市場的滲透率提升以及工業控制市場需求回暖等帶動平均訂單量增加，客戶數量穩步增長。

於截至2025年及2026年3月31日止三個月期間，我們的收入增長主要受以下各項的銷售增加所帶動：(i)車規級及工業級存儲芯片，主要歸因於我們持續進行的市場擴

概 要

張工作與技術進步促使市場滲透進一步深化，以及獲得國際領先汽車品牌的訂單；及(ii)NFC芯片，是由於我們拓展至新應用場景。於期內，我們的淨利潤有所下降，主要由於(i)我們的產品組合變動，(ii)研發開支增加，(iii)並無上市證券投資收益，及(iv)以權益結算的股份薪酬增加。

我們的經調整淨利潤(非國際財務報告準則指標)由2023年的人民幣127.3百萬元大幅增加至2024年的人民幣305.3百萬元，並進一步增加至2025年的人民幣388.2百萬元。經調整淨利潤(非國際財務報告準則指標)增加主要是由於我們的年內利潤持續增加，部分被每年加回以權益結算的股份支付安排所抵銷。我們的經調整淨利潤(非國際財務報告準則指標)由截至2025年3月31日止三個月的人民幣101.1百萬元減少至2026年同期的人民幣56.4百萬元，主要由於(i)我們的產品組合變動，(ii)研發開支增加，及(iii)並無上市證券投資收益。

綜合財務狀況表概要

下表載列我們截至所示日期的綜合資產負債表的選定資料，該等資料摘錄自本文件附錄一所載會計師報告：

	截至12月31日			截至3月31日
	2023年 人民幣	2024年 人民幣	2025年 人民幣	2026年 人民幣
	(以千元計)			
非流動資產總值	321,950	387,838	522,625	521,038
流動資產總值	1,728,262	1,917,479	2,225,039	2,246,752
流動負債總額	96,754	132,966	165,258	130,653
流動資產淨值	1,631,508	1,784,513	2,059,781	2,116,099
資產總值減流動負債	1,953,458	2,172,351	2,582,406	2,637,137
非流動負債總額	10,847	10,305	10,276	8,867
資產淨值	1,942,611	2,162,046	2,572,130	2,628,270

於往績記錄期間，我們的資產淨值持續增加。我們的資產淨值由截至2023年12月31日的人民幣1,942.6百萬元增加至截至2024年12月31日的人民幣2,162.0百萬元，主要由於(i)我們於2024年錄得的利潤人民幣276.0百萬元，及(ii)以權益結算的股份支付安排人民幣50.6百萬元，部分被(i)回購及註銷A股股份支付的款項人民幣81.8百萬元及(ii)我們於2024年宣派及派付的股息人民幣31.5百萬元所抵銷。我們的資產淨值進一步增加至截至2025年12月31日的人民幣2,572.1百萬元，主要由於(i)我們於2025年錄得的利潤人民幣355.8百萬元，(ii)以權益結算的股份支付安排人民幣42.4百萬元，及(iii)以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的股權投資公允價值(扣除稅項)增加人民幣58.3百萬元，部分被我們於2025年宣派及派付的股息人民幣47.4百萬元所抵銷。我們的流動資產淨額由截至2025年12月31日的人民幣2,059.8百萬元增加至截至2026年3月31日的人民幣2,116.1百萬元，主要由於(i)我們於截至2026年3月31日止三個月錄得的利潤人民幣32.5百萬元，及(ii)截至2026年3月31日止三個月的以權益結算的股份支付安排人民幣23.9百萬元。

綜合現金流量表概要

下表載列我們於所示年／期內的現金流量概要：

	截至12月31日止年度			截至3月31日止三個月	
	2023年 人民幣	2024年 人民幣	2025年 人民幣	2025年 人民幣	2026年 人民幣
	(以千元計)			(未經審核)	
經營活動所得現金流量淨額	102,709	302,093	399,097	71,257	16,200

概 要

	截至12月31日止年度			截至3月31日止三個月	
	2023年 人民幣	2024年 人民幣	2025年 人民幣 (以千元計)	2025年 人民幣	2026年 人民幣
投資活動(所用)／所得現金					
流量淨額.....	(132,822)	(225,369)	(208,765)	240,165	(10,704)
融資活動(所用)／所得現金					
流量淨額.....	(93,397)	(96,609)	(48,500)	5,131	(15,861)
現金及現金等價物(減少)／					
增加淨額.....	(123,510)	(19,885)	141,832	316,553	(10,365)
年／期初現金及現金等價物.....	717,324	592,822	577,701	577,701	711,171
現金及現金等價物的匯兌					
(虧損)／收益.....	(992)	4,764	(8,362)	(163)	(6,054)
年／期末現金及現金等價物.....	592,822	577,701	711,171	894,091	694,752

我們於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月分別錄得投資活動現金流出淨額人民幣132.8百萬元、人民幣225.4百萬元、人民幣208.8百萬元及人民幣10.7百萬元，主要歸因於(i)購買結構性存款；(ii)於上市公司及私人公司的股權投資；及(iii)對私募股權基金的投資。截至2026年3月31日，低風險結構性存款佔我們以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的90.8%。

我們已採納結構化內部審閱機制以管理我們的投資。請參閱「財務資料－有關綜合財務狀況表若干主要項目的討論－以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產」。在選擇投資產品時，我們按個案基準評估投資，並考慮宏觀經濟環境、一般市場狀況、投資經理的風險控制及信貸狀況、我們的營運資金需求及預期回報或潛在虧損等因素。

主要財務比率

	截至12月31日			截至3月31日
	2023年	2024年	2025年	2026年
淨利潤率.....	11.8%	26.8%	29.1%	11.6%
毛利率.....	46.6%	54.8%	57.3%	48.9%
流動比率.....	17.9	14.4	13.5	17.2
速動比率.....	15.5	12.6	11.8	14.9
資產負債比率.....	5.2%	6.2%	6.4%	5.0%
貿易應收款項週轉天數.....	74	47	42	47

有關主要財務比率的計算，請參閱「財務資料－主要財務比率」。

風險因素

我們的業務及[編纂]涉及「風險因素」一節所載的若干風險。閣下於決定[編纂]我們的股份前應細閱該節全部內容。我們面臨的部分主要風險包括：(i)半導體行業競爭非常激烈且發展迅速。倘我們無法與現有或新競爭對手有效競爭，我們的銷售、市場

概 要

份額及盈利能力可能受到不利影響；(ii)市場競爭造成的價格壓力及市場狀況的動盪可能對我們的收入及毛利率產生負面影響；(iii)我們未來的成功取決於及時開發、推出、營銷及銷售新半導體解決方案與技術及現有產品及技術的迭代，而我們可能無法做到，開發更複雜的新解決方案與技術亦可能增加我們的銷售成本，並對毛利率產生不利影響；(iv)我們依賴第三方代工廠，這一情況降低我們對生產流程的控制能力，該等代工廠的任何中斷、產能不足或失能均可能對我們的業務運營與產品供應造成重大中斷，且採購成本的大幅增加亦可能影響我們的毛利率；及(v)我們的毛利率可能會出現波動，並可能受到原材料成本上漲及我們下游市場疲弱的不利影響，其中任何一項均可能對我們的經營業績造成重大不利影響。

我們的單一最大股東集團

陳作濤先生是本公司董事長兼執行董事。陳作濤先生、陳作寧先生（陳作濤先生的親兄弟）、天壕科技及天壕投資構成我們的單一最大股東集團，緊接[編纂]前持有本公司已發行股本約21.03%，緊隨[編纂]完成後持有本公司已發行股本約[編纂]%（假設概無根據[編纂]及限制性股份激勵計劃發行任何新股，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間概無其他變動）。有關我們單一最大股東集團的進一步詳情，請參閱「與單一最大股東集團的關係」一節。

於上海證券交易所科創板上市及於香港聯交所H股[編纂]之理由

本公司自2019年12月起於上海證券交易所科創板上市。自於上海證券交易所科創板上市以來及直至最後實際可行日期，我們並無於任何重大方面重大違反上海證券交易所規則及中國其他適用證券法律法規之情況。中國法律顧問表示，未發現任何與我們在上海證券交易所科創板的合規記錄相關的、須提請[編纂]注意的重大事項。我們的中國法律顧問認為，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度及直至最後實際可行日期，我們在所有重大方面均已遵守適用於我們的A股上市之相關法律法規。本公司尋求於香港聯交所[編纂]，旨在為我們業務的發展與擴張籌集更多資金、進一步提升海外融資能力、進一步拓展全球戰略佈局，並更好地吸引海外投資者與人才。

股息政策

我們於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月分別派付股息人民幣106.8百萬元、人民幣31.5百萬元、人民幣47.4百萬元及零。詳情請參閱「財務資料—股息政策」。我們的2025年年終利潤分配方案於2026年4月10日舉行的2025年股東週年大會上獲批准。其後，我們於2026年4月27日自可供分配利潤向截至2026年4月24日記錄在冊的股東派發每10股股份人民幣7.0元（含稅）的現金股息，合共約人民幣110.8百萬元。截至最後實際可行日期，概無任何未支付應付股息。

我們的股息政策於公司章程訂明。我們可通過現金、股票或現金與股票結合的形式向股東分派股息，且最近三年以現金形式（包括以股份購回方式）分配的累計利潤原則上不得低於最近三年歸屬於本公司所有者的年平均經審核淨利潤的30%。我們並無預定派息比率。

[編纂]

假設[編纂]未獲行使，每股[編纂][編纂]為[編纂]港元（即[編纂]範圍的中位數）並全額支付[編纂]（如有），我們預計將產生約[編纂]百萬港元的[編纂]（包括：(i)[編纂]的開支，包括但不限於佣金、費用、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交

概 要

所[編纂]費)，約[編纂]百萬港元；(ii)法律顧問及會計師費用及支出，約[編纂]百萬港元；及(iii)與[編纂]相關的其他費用及支出（包括但不限於[編纂]費用），約[編纂]百萬港元），佔[編纂][編纂]總額的約[編纂]。約[編纂]百萬港元的[編纂]預計計入我們的綜合全面收益表，約[編纂]百萬港元預計於[編纂]時從權益中扣除。於往績記錄期間，我們並無產生[編纂]。上述[編纂]估計乃最近實際可行估計，僅供參考，實際金額可能與此估計有所不同。

未來計劃及[編纂]

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元（即[編纂]範圍每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），且[編纂]未獲行使，根據我們的戰略，我們擬將[編纂][編纂]按下述金額用於下述用途：(i)[編纂]約[編纂]或[編纂]百萬港元預計將用於加強我們的核心存儲類芯片及混合信號技術以及相關設計及處理平台的開發，旨在鞏固支撐我們未來產品組合的核心技術壁壘，以進一步推動我們產品矩陣的持續拓展；(ii)[編纂]約[編纂]或[編纂]百萬港元，預計將用於完善我們的全球供應鏈佈局、強化中國境外團隊建設及海外營銷推廣活動；(iii)[編纂]約[編纂]或[編纂]百萬港元，預計將用於戰略投資及／或收購；及(iv)[編纂]約[編纂]或[編纂]百萬港元，預計將用於營運資金及一般企業用途。

[編纂]

概 要

近期發展

我們的2025年年終利潤分配方案已於2026年4月10日舉行的2025年股東週年大會上獲批准。其後，我們於2026年4月27日從可分派利潤中向於2026年4月24日名列冊上的股東派付了每10股股份人民幣7.0元（含稅）的現金股息，總額約為人民幣110.8百萬元。

於2026年4月，我們投資若干上市證券，並截至最後實際可行日期錄得重大公允價值收益。倘不計及該等上市證券的公允價值變動，我們的淨利潤可能於2026年下降，主要是由於：(i)我們的產品組合可能出現變動，原因是我們利潤率較高的存儲芯片產品的下游市場預期將面臨阻力；(ii)計劃增加研發開支以支持我們研發活動擴展；及(iii)額外的以股份為基礎的薪酬開支。因此，即使我們的收入於2026年繼續增長，我們的淨利潤及淨利潤率可能於2026年下降。

我們的董事確認，截至本文件日期，除上文所述者外，我們的業務、財務狀況及經營業績自2026年3月31日（即本文件附錄一會計師報告呈報期間的結束日期）以來並無重大不利變動，且自2026年3月31日以來並無發生會對本文件附錄一會計師報告所載資料造成重大影響的事件。